

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2020-047

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于增资参股浙江晶睿电子科技有限公司暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“甲方”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增资参股浙江晶睿电子科技有限公司暨对外投资的议案》，公司拟向浙江晶睿电子科技有限公司增资人民币9,000万元，并签署相关投资协议。具体内容如下：

一、对外投资概述

1、2020年7月24日，公司与浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”或“目标公司”或“丙方”）及晶睿电子公司的股东张峰（以下或称“乙方”）签订投资协议，约定由公司向目标公司增资9,000万元，增资完成后目标公司注册资本总额为2,818.1818万元，公司持有其29.0323%股权。全部增资款中，818.1818万元作为目标公司的注册资本，增资溢价部分8,181.8182万元计入目标公司的资本公积。增资款全部为公司自有资金。

2、公司于2020年7月24日召开第二届董事会第十九次会议审议《关于增资参股浙江晶睿电子科技有限公司暨对外投资的议案》，表决通过本次对外投资事项。本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需政府有关部门的审批。

二、交易对手介绍

1、浙江晶睿电子科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91331100MA2E3ENF7P

成立日期：2020年5月25日

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道张村路25号万侨国际总部-171

注册资本：2,000万人民币

法定代表人：张峰

经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、张峰

身份证号码：3102221970xxxxxxxx

张峰目前持有浙江晶睿电子科技有限公司100%股权，为目标公司控股股东和实际控制人。

公司与交易对方不存在关联关系，交易对方亦非失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次投资以自有资金出资

2、标的公司名称：浙江晶睿电子科技有限公司

3、标的公司简介：晶睿电子主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，是一家半导体硅片制造企业。半导体硅片的产业链上游是多晶硅制造业，产业链下游主要是集成电路与分立器件制造业。半导体硅片属于半导体产业的核心基础材料，是作为生产制造包括集成电路、半导体分立器件等在内的各类半导体产品的载体。晶睿电子目前在筹办期，拟建设半导体硅外延片生产项目，建设完成后，公司主营业务为6、8、12英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售。其主要产品包括在硅抛光片上的外延，器件工艺过程中的埋层外延，以及功率器件Cool MOS中的外延等。同时，晶睿电子会从事硅基GaN和SiC外延的研发和小批量生产。具体情况详见公司同时披露的《关于增资参股浙江晶睿电子科技有限公司暨对外投资的可行性研究报告》。

4、本次增资完成前，晶睿电子的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	张峰	2,000.00	100.00%
合计		2,000.00	100.00%

5、本次增资完成后，晶睿电子的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	张峰	2,000.0000	70.9677%
2	深圳市民德电子科技股份有限公司	818.1818	29.0323%
合计		2,818.1818	100.00%

6、标的公司财务状况

标的公司为新设立的公司，目前处于公司前期投入阶段，各项筹备工作正在有序地开展，主要包括经营团队的组建、市场的前期拓展等，还未产生实际经营业绩。

7、标的公司主要人员情况

7.1、执行董事/总经理/核心技术人员：张峰，男，生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权。1997年获中科院上海冶金所材料物理专业博士学位，1998年1月-2000年9月，担任中科院上海冶金所助理研究员；2000年10月-2006年3月，担任中科院上海微系统与信息技术研究所研究员、博导；2001年8月-2016年2月，先后担任上海新傲科技股份有限公司经理、常务副总、总经理；2016年3月-2018年5月，任上海硅产业投资有限公司副总裁；2020年5月-至今，任浙江晶睿电子科技有限公司总经理。张峰先生作为负责人参与了包括国家863项目、国家科技重大项目、上海市高新技术产业化重大项目计划等在内的多项国家及省市重大科研项目，荣获国家科技进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中科院杰出科技成就奖等奖项，并获得全国五一劳动奖章、上海市劳动模范、上海市领军人才等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴。张峰先生共发表论文70余篇，已申请和获授权20余项国家发明专利，1项国际专利。

7.2、高级管理人员：杨建，男，生于1978年6月，中国国籍，无境外永久居留权。2000年本科毕业于上海交通大学材料学专业，2015年获上海交通大学工商管理专业硕士学位。2000年9月-2003年3月，任上海合晶硅材料有限公司担任抛光部经理；2003年4月-2018年3月，先后担任上海新傲科技股份有限公司厂长、质量总监、采购总监、总经理助理等职。杨建先生从事半导体行业近20年，拥有2项发明专利，对半导体产业链有深刻理解，熟悉公司质量体系，并精通公司运作。

8、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，该公司亦非失信被执行人。

四、协议的主要内容

1、定价依据及投资金额

基于大硅片产业良好发展前景以及乙方团队成熟产业化经验，经各方协商一致，确定目标公司投前估值为人民币 2.2 亿元（其中，团队承诺将于 2025 年 12 月 31 日完成 2,000 万元注册资金实缴）。

各方协商一致，确定以目标公司投前估值 2.2 亿元为基础，甲方以 9,000 万元向目标公司增资，持有目标公司 29.0323% 股权。目标公司拟增加注册资本 818.1818 万元，甲方此次增资金额 9,000 万元中，增资款 818.1818 万元计入目标公司实收资本，其余增资款 8,181.8182 万元计入目标公司资本公积。

2、增资款项支付

2.1 支付的前提条件

在甲方支付增资款前，乙方应确保完成以下事项：

（1）本次目标公司增资决议事项已获得目标公司相应权力机构审批通过并生效，乙方对本次增资放弃优先认购权；

（2）本协议已经由相关当事方有效及适当的签署；

（3）目标公司已在各方均认可的商业银行开立本次增资所需的银行账户专户；

（4）自本协议签署日至甲方支付增资款前，没有发生对目标公司的财务状况、经营成果、资产、业务等重大不利影响的事件；

（5）乙方在所有重大方面履行和遵守本协议项下其应当履行或遵守的所有义务和承诺，其所提供给甲方的所有信息和资料是真实、完整、合法并有效的。

2.2 付款方式

在满足上述付款的前提下，甲方将于 2020 年 12 月 31 日前将 9,000 万元增资款分期支付至各方共同指定的银行账户专户，分期全部实缴所认缴的目标公司注册资金。上述增资款的分期支付，将保障目标公司项目建设进度及正常运营资金需求，具体缴付安排由甲方、丙方协商确定。

2.3 增资款监管

鉴于目标公司创立初期团队建设及公司内部治理和内控体系建设需要一定时间，为确保本次交易 9,000 万元增资款项使用的合规合理性，各方同意甲方将 9,000 万元增资款分期支付至各方共同指定的银行账户专户，且由甲方指定专人对该账户资金使用情况进行监管，直至本次 9,000 万元增资款项全部支出为止。

原则上，对于目标公司正常土建、设备采购、日常经营款项支出，甲方在审核该款项合规性后，均须予以审批支付。如甲方在资金支付审核时发现重大风险，则由甲方与乙方协商处理。

满足以下两种情形中的任意一种情形，甲方取消对于上述银行账户专户资金的监管权限，由丙方按其公司章程及财务管理规定进行相应资金支付审批：1) 该银行账户专户 9,000 万元增资款全部支出完毕，甲方取消专户监管权限；2) 甲、乙双方共同认定，丙方已建立完备团队，公司内部治理及内控体系建设相对完善，甲方出具书面认可说明，甲方取消专户监管权限。

3、保证与承诺

3.1 协议各方承诺，各方均拥有订立和履行本协议所需的权利能力和行为能力，或已经获得一切必需的授权，并保证本协议能够对各方具有法律约束力。

3.2 本次增资款项应作为目标公司的生产经营及补充目标公司流动资金的用途，不能用于其他用途。

3.3 乙方承诺，将于 2025 年 12 月 31 日前完成其在丙方 2,000 万注册资金实缴义务。

3.4 本次增资后，甲方持有丙方 29.0323%的股权，丙方成为甲方的参股公司。丙方设董事会，董事会人数为 3 人，甲方有权推举 1 名董事，乙方有权推举 2 名董事，董事长由乙方推举的董事担任。丙方设监事 1 名，由乙方推举。丙方总理由乙方提名并经董事会聘任，法定代表人由总经理担任；财务负责人由乙方提名并经董事会聘任。

3.5 乙方保证其向甲方提供关于目标公司的任何资料均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大疏漏。

3.6 乙方保证其在目标公司中不存在挪用资产和虚列费用的情形，并保证目标公司在财务会计方面账账相符、账实相符，会计核算符合相关法律法规。

3.7 乙方保证对本次增资工商变更完成之前所形成的目标公司或有负债，包括但

不限于目标公司历年欠缴的税款、对外担保、因被有关主管部门行政处罚所欠缴的罚款、因违法行为或与第三方的经济纠纷所产生的现时或潜在债务等，均由乙方按其目标公司增资前的股权比例承担。

3.8 在甲方持有目标公司股权期间，自本协议签署生效后至丙方公开发行股票上市前或2030年7月1日(以两者孰早者为准)，乙方承诺并保证在目标公司持续工作，并将其主要精力集中于目标公司的经营发展，履行勤勉尽责义务，并保证不再以其他名义从事与目标公司相同或类似的半导体材料类业务。如乙方在该期间内主动离职，则由乙方向甲方支付本次交易总额20%（1,800万元）的违约赔偿金。在本协议签署生效后，乙方应确保经甲方、乙方共同认定的目标公司核心人员与目标公司签署任职期限不少于三年的劳动合同和竞业禁止协议（在职及离职后三年）。乙方在目标公司任职期间及离职后三年内，未经甲方书面同意，不得以任何方式在目标公司以外，从事与目标公司相同或者类似的半导体材料类业务，或者通过直接或者间接控制的其他经济体从事该等业务，或者在与目标公司有竞争关系的企业任职。如乙方违反本条约定，收入所得归甲方所有，还须向甲方支付本次交易总额20%（1,800万元）的违约赔偿金。本条所涉及乙方主动离职和违反竞业禁止所产生的违约赔偿金，不得重复计算。

3.9 丙方保证在本协议签署生效后，甲方支付完首期股权增资款（不低于2,000万元）后的10个工作日内完成工商变更登记。

3.10 丙方保证本次增资后，建立健全公司治理结构，完善规章制度，并在日常经营活动中严格执行。

3.11 自本协议签署生效后至丙方公开发行股票上市前，乙方保证不得将其在目标公司所持控股股权进行转让、质押、担保等交易，如涉及任何可能导致乙方在目标公司控股股权发生变更的事项，均须经过甲方书面同意方可生效。如乙方将所持有股权进行对外转让、质押、担保等交易，且不会或不可能导致目标公司控股权变更的，则不受本条款限制。

4、投资方的权利

4.1 甲方成为目标公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，目标公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由甲方按其持股比例享有。

4.2 优先认购权：目标公司若后续进行新增注册资本、可转债等任何形式的股权

融资(公开发行股票和团队股权激励除外),在同等条件下,甲方有权享有优先认购权。

4.3 查阅权:甲方享有对目标公司经营的查阅权,有权在事先通知的情况下查询、获取目标公司的下列信息,包括但不限于:与公司的董事、监事、管理人员、雇员、会计人员、法律顾问和保荐机构商讨业务、财务及资本运作情况等。目标公司当年业绩明显低于当年预算(或经营计划数据)或有证据表明公司发生重大侵害投资方利益的情形时,甲方有权派驻人员对公司进行检查(范围包括但不限于会计报表、会计账簿、会计原始凭证和附件、相关报告或材料等)或其他方式的检查,目标公司、原股东应予以配合。

4.4 甲方有权向目标公司管理层提出建议并与之进行商讨。

4.5 知情权:本次增资完成后,目标公司应在其月度/年度财务报表及审计报告出具后 10 日内向甲方相应投资对接人员提供。

自本协议签署之日起,目标公司应就重大事项或可能对目标公司造成潜在义务的事项及时通知甲方,包括目标公司进行的法律诉讼和其他可能的债务。重大事项包括但不限于以下内容:

(1) 经营方针和经营范围的重大变化;

(2) 订立重要合同,而该合同可能对目标公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响;

(3) 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况;

(4) 发生重大亏损或者遭受超过净资产 5%以上的重大损失;

(5) 生产经营的外部条件发生重大变化;

(6) 涉及目标公司的重大诉讼,法院依法撤销股东会、董事会决议;

(7) 目标公司认为需要通报的其他重大事项。

5、丙方融资计划

5.1 为保障丙方项目建设与经营工作正常推进,乙方承诺:除本次甲方 9,000 万元增资款(2020 年 12 月 31 日前完成出资)和乙方 2,000 万元注册资金实缴款(2025 年 12 月 31 日前完成出资),乙方将于 2021 年 12 月 31 日前主导完成并实际收到目标公司不低于 1.1 亿元人民币的新增股权融资(后续新增股权融资估值水平不得低于本次甲方增资后目标公司的估值水平)。

5.2 截止到 2021 年 12 月 31 日,如目标公司上述新增股权融资金额低于 1.1 亿元

人民币（不含甲方 9,000 万元增资款和乙方 2,000 万元注册资金实缴款），导致丙方实际融资金额低于 2.2 亿元，则需要调减甲方增资 9,000 万时丙方的初始估值 2 亿元（不含 2,000 万元注册资金实缴款），并按照新估值计算甲乙之间的股权分配比例，缩减的差额估值所对应的丙方股权比例由乙方以 1 元对价全部转让给甲方享有。

5.2.1 假设截止到 2021 年 12 月 31 日，目标公司上述新增股权融资金额为 X 亿元人民币（ $X < 1.1$ ），此时调整后的丙方初始估值为 Z 亿元人民币，调整后甲方占甲乙双方合计持有股权比例为 W，则以上数据计算公式如下：

$$\text{估值调整公式: } \frac{2.2}{2} = \frac{X + 1.1}{Z}, \text{ 即新估值 } Z = \frac{X}{1.1} + 1$$

$$\text{估值调整后甲方占甲乙双方合计股权比例 } W = \frac{0.9}{Z + 1.1} = \frac{0.9}{\frac{X}{1.1} + 1 + 1.1} = \frac{0.99}{X + 2.31}$$

5.2.2 举例如下：现假设后续新增融资额 $X=0.8$ 亿元人民币，且 0.8 亿元融资前估值=3.1 亿元人民币，融资后估值为 3.9 亿元人民币，则此时：

- (1) 甲乙双方合计享有丙方股权比例=3.1/3.9=79.4872%；
- (2) 按照丙方新初始估值计算的甲方占甲乙双方合计股权比例 $W=0.99/(0.8+2.31)=31.8328\%$ ；
- (3) 按照新估值水平计算甲方应享有的丙方股权=31.8328%*79.4872%=25.3030%；
- (4) 按照原估值水平计算甲方应享有的丙方股权=0.9/3.9=23.0769%；
- (5) 新估值水平下甲方应享有的丙方股权比例差额=25.3030%-23.0769%=2.2261%，则此时乙方需将 2.2261%的丙方股权以 1 元价格转让给甲方，使得甲方最终持有丙方股权比例达到 25.3030%。

6、违约责任

6.1 本协议签署后，甲方应当按期足额向目标公司支付相应增资款项，乙方和目标公司应当完全履行其在本协议项下的各项义务。若截止 2020 年 12 月 31 日，甲方仍未完成 9,000 万元增资款的全部出资，且甲方未提出任何正当理由，则甲方应当承担违约责任，每逾期一日，按应付款项的 0.5% 支付违约金。

6.2 除本协议第 7.1 款、第 5.1 款规定的情形以外，本协议签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定事项的，均构成违约。一方构成违约后，经另一方提醒 15 日内仍未及时整改的，违约方应当向非违约交易对方支付违约金 300.00 万元。

7、不可抗力

7.1 鉴于甲方为中国深圳证券交易所上市公司，若因监管机构或行政主管部门否决本次增资等不可抗力原因导致甲方取消本次增资的，甲方可免于承担违约责任。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

1.1 深化公司半导体产业链战略布局

公司自上市以来，逐步确立了拓展半导体产业的企业战略。2018年6月，公司通过全资收购深圳市泰博迅睿技术有限公司，进入半导体元器件分销行业；2020年6月，公司通过控股收购广微集成（深圳）技术有限公司，进入功率半导体设计行业。本次参股投资晶睿电子，布局半导体大硅片业务，将进一步深化公司在半导体产业战略布局，有助于公司获取更多半导体行业关键资源和能力，增强公司产业竞争力和可持续发展能力。

1.2 加强公司功率半导体产业供应链安全稳定

硅片是半导体制造过程中最主要的原材料，且在原材料中成本占比最高。半导体为强周期性行业，上游原材料的稳定供应，对于下游的功率半导体设计企业尤为重要。通过参股晶睿电子，彼此间建立高度信任，促成公司与上游大硅片制造企业的深度战略联盟，从而确保公司功率半导体设计业务大硅片原材料的供应安全和稳定。

1.3 提升公司功率半导体设计业务产品开发效率

“特色工艺”在整个功率半导体产业链中扮演至关重要的作用，具体体现在：器件的独特设计、硅片的定制开发、晶圆厂特色工艺平台的开发、芯片的定制封装等方面。一款新功率器件产品的开发，需要芯片设计企业调动硅片厂、晶圆厂、封装厂等多方资源予以配合，进行定制化开发，以满足客户需求。通过参股晶睿电子，公司在功率器件新产品开发方面，会得到硅片厂的高效支持，进一步提升公司功率半导体设计业务产品开发效率，增强公司功率半导体业务的市场竞争力。

2、投资的可行性

2.1 市场空间广阔，国内尚未形成垄断格局

半导体硅片市场广阔，2019年全球半导体硅片销售额达112亿美元。虽然全球领域五家龙头企业占据9成以上市场份额，但中国市场仍处于快速发展阶段，尚未形成

垄断格局。中国作为全球最大的半导体产品终端市场，预计未来随着中国芯片制造产能的持续扩张，中国半导体硅片市场的规模将继续以高于全球市场的速度增长。在技术方面，我国 12 英寸硅片生产技术与国外先进企业仍有明显差距，但在 8 英寸及以下特色工艺硅片生产技术上已相对比较成熟，细分领域市场机会丰富。

2.2 行业资深技术团队，具有丰富、成熟的产业化经验

以张峰博士为首的核心技术团队，是国内最早从事半导体大硅片技术攻关的团队之一，承接了一系列与大硅片有关的国家重大技术攻关项目，见证了中国大硅片生产技术的演进和发展。该团队有着丰富、成熟的大硅片产业化经验，行业上下游资源积淀深厚，对半导体以及大硅片产业的发展趋势和技术迭代路线有着清晰、深刻的理解。因此，基于项目团队过往成功产业化经验，本项目在技术实施方面有较高的可行性；同时在市场开拓方面，项目团队在下游有着丰富、成熟的国内外客户资源，有助于其进行前期的市场开拓。

2.3 公司功率半导体设计业务为晶睿电子提供市场验证支持

硅片的销售前期验证周期较长，一般耗时数月。晶睿电子公司投产后，公司控股子公司广微集成将优先采购其硅片，协同晶圆代工厂进行制造工艺、技术参数的调试，争取在尽量短的时间内完成硅片测试验证，并向晶睿电子下单批量采购，支持其产量稳步提升。通过广微集成的批量采购和市场验证，逐渐形成市场口碑，有助于其他客户的开拓。

2.4 丽水市政府给予优厚政策支持

晶睿电子项目所在地浙江丽水市政府给予该项目优厚政策支持，并已签署相关项目合作框架协议书和投资意向书，主要政策包括：1) 丽水市绿色产业发展基金有限公司拟对晶睿电子进行 8,000 万元股权投资；2) 根据建设进度，给予一定金额土地出让金返还，最高返还 11 万元/亩；3) 对约定期限内的固定资产投资（不含土地）给予 20% 补贴；4) 在约定期限内，对晶睿电子在地方的综合贡献给予一定奖励返还。

3、存在的风险

3.1 项目执行风险

晶睿电子项目为“老团队，新平台”，团队在技术上有成熟产业化经验，且市场资源丰富。但该项目公司毕竟为初创企业，后续面临土建、设备安装与调试、试生产、市场营销等诸多环节，以及团队组建、内部运营管理制度建设等任务，面临诸多挑战

与不确定性，存在项目执行过程风险。

防范措施：公司将督促项目团队积极做好项目执行计划，并快速迭代反馈，做好人才储备工作，在必要时公司也将为目标公司提供相应资源支持。

3.2 资金短缺风险

本项目固定资产投资金额约 2.22 亿元，目前融资计划如下：本公司股权投资 9,000 万元，丽水市绿色产业发展基金有限公司意向股权投资 8,000 万元，团队计划出资 2,000 万元。在本公司投资出资后，如后续其他投资者资金未能及时到位，或项目实际资金需求明显超出预算，则目标公司有可能面临资金短缺风险，影响项目的推进效率。

防范措施：本公司将积极督促项目团队与各意向出资人保持积极沟通，及早完成项目投资出资，并积极与后续潜在意向投资机构保持联系，为后续股权融资做好储备；目标公司也将视需求，适当开展银行等债权融资工作。

3.3 市场开拓风险

半导体行业与宏观经济起伏关联度高，市场存在波动风险。且半导体硅片产业从投产到客户验证、再到批量出货，要经历较长的周期，这将导致产品在开拓新客户新市场时会面临较大的不确定性。

防范措施：做好前期客户沟通工作，整合上下游供应链资源，建立高效的反馈机制，及早进行产品验证并尽量缩短验证周期。

3.4 项目投资损失风险

目标公司为初创企业，项目在建设、运营过程中存在诸多项目执行风险，进而有可能使得项目运营效益不达预期，造成投资损失风险。

防范措施：公司将积极关注项目进展，在必要时给予资源支持，尽量避免投资损失风险。

4、对公司的影响

公司通过参股投资晶睿电子布局半导体大硅片业务，本次投资契合民德电子的战略发展规划，有助于民德电子进一步深化半导体产业布局，从而延伸功率半导体产业链，增强公司产业竞争力；同时也有助于公司半导体设计业务与晶睿电子发挥协同效应，扩大经营规模，提升经营效率，从而开拓更广阔的市场空间。

公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求及时进行相关的

信息披露。

六、备查文件

- 1、深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- 2、关于浙江晶睿电子科技有限公司之增资协议
- 3、关于增资参股浙江晶睿电子科技有限公司暨对外投资的可行性研究报告

特此公告！

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日